

tesa[®] HAF 8440

Información De Producto



Cinta termoactivable

Descripción del producto

tesa HAF 8440 es una cinta termoactivable de doble cara, translúcida, basada en una copoliamida termoplástica.

Aplicaciones

tesa HAF 8440 está diseñada para la implementación de chips en tarjetas.

- Adecuado para tarjetas de PVC, ABS, PET y PC.
- Funciona perfectamente en toda las líneas de implementación de chips.
- Resistencia al envejecimiento.
- Invisible una vez aplicado en la tarjeta.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|----------|
| • Material de soporte | ninguno | • Tipo de liner | glassine |
| • Tipo de adhesivo | copoliamida | • Espesor total | 40 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- Fuerza de adhesión (esfuerzo dinámico) 12 N/mm²

Información adicional

Recomendaciones técnicas para aplicación en tarjetas con chip.:

Los siguientes valores son recomendaciones de los parámetros de la máquina para empezar. Los parámetros óptimos dependen del tipo de máquina, de los materiales con que están hechas las tarjetas, de los chips y de los requerimientos del cliente.

1- Pre-laminación:

Durante la pre-laminación la cinta se lamina sobre la tira que contiene los chips. Este proceso se puede llevar a cabo inline o offline. La pre-laminación no afecta a la caducidad de la cinta. Los módulos pre-laminados pueden ser almacenados durante el mismo tiempo que la caducidad de la cinta.

Configuración de la máquina:

- Temperatura 130 - 140°C
- Presión 4 - 6 bar
- Tiempo 1,5 - 3 sec.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=8440>

tesa[®] HAF 8440

Información De Producto

Información adicional

2.- Implementación de los chips.

Durante la implementación de los chips, estos son cortados de la tira de chips, posicionados en la cavidad de la tarjeta y unidos permanentemente a la tarjeta. En este paso, los parámetros dependen del tipo de equipo usado. Actualmente hay dos formas de hacerlo:

Proceso con un sólo paso - Configuración de la máquina (baja temperatura):

- Temperatura¹ 160 – 190 °C
- Presión 65 N/chip
- Tiempo 2,0 – 4,0 s

Un sólo paso - Configuración de la máquina (alta temperatura):

- Temperatura¹ 180 – 210 °C
- Presión 65 N/chip
- Tiempo 1 – 1,5 s

Proceso con varios pasos (2 o más cabezales con temperatura) - Configuración de la máquina:

- Temperatura¹ 180 – 200 °C
- Presión 65 N/chip
- Tiempo (para cada paso) 0,7 – 1,2 s

¹ Temperatura medida dentro del cabezal con temperatura.

Para otras aplicaciones diferentes de las tarjetas chip otros parámetros de configuración deberían de ser usados. Ver las condiciones de almacenaje de las cintas tesa[®] HAF para la caducidad de las mismas.

Nota: Los valores de adhesión son obtenidos bajo condiciones de laboratorio standard (valores medios). Condiciones del test: Mater

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=8440>